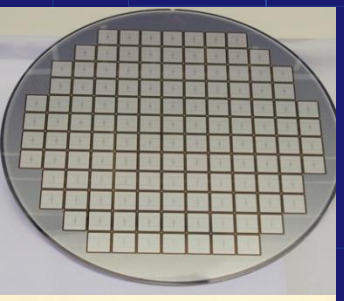
杭州立昂微电子股份有限公司
2021年半年度业绩说明会



上海

2021年08月31日

目录

一．公司简介

二．2021年上半年经营业绩

三．2021年下半年经营计划

公司简介—发展现状

- 2002年，半导体材料开拓者阙端麟院士创立了“杭州立昂微电子股份有限公司”，是我国具有集成电路用硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片及芯片制造的完整产业链的集成电路企业，也是行业内屈指可数的从硅片到芯片的一站式制造平台。

- 截止2021年6月30日，实收资本40,058万元人民币，员工1,917人，其中享受国务院特殊津贴1人、省“千人计划”1人、硕士以上学历100余人，形成了产、学、研、用一体化的产业平台。

- 在杭州、宁波、衢州设有三大生产基地，拥有杭州立昂东芯微电子有限公司、浙江金瑞泓科技股份公司(宁波)、金瑞泓科技（衢州）有限公司、金瑞泓微电子（衢州）有限公司、杭州立昂半导体技术有限公司、海宁立昂东芯微电子有限公司六家子公司。

公司简介—主营业务

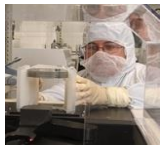
杭州立昂微电子股份有限公司
（股票代码：605358）

金瑞泓

半导体硅晶圆

6英寸、8英寸、12英寸硅片

硅外延片制造



硅抛光片制造

单晶硅锭制造

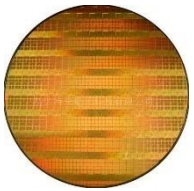
多晶硅制造

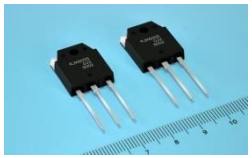
立昂微

半导体功率器件芯片

SBD、MOS、TVS、FRD

硅半导体芯片制造行业





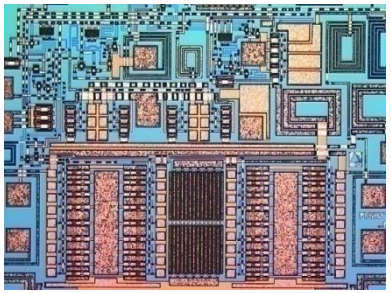
功率肖特基芯片 MOSFET(场效应晶体管)

立昂东芯

集成电路微波射频芯片

HBT、PHEMT、BIHEMT、VCSEL

化合物半导体芯片制造行业



第一代半导体

第二、三代半导体

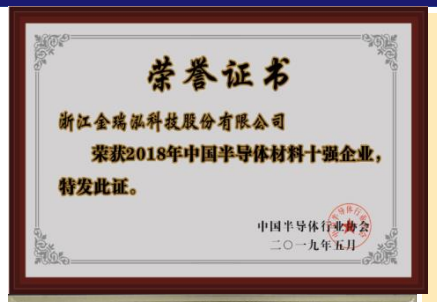
公司简介—行业地位

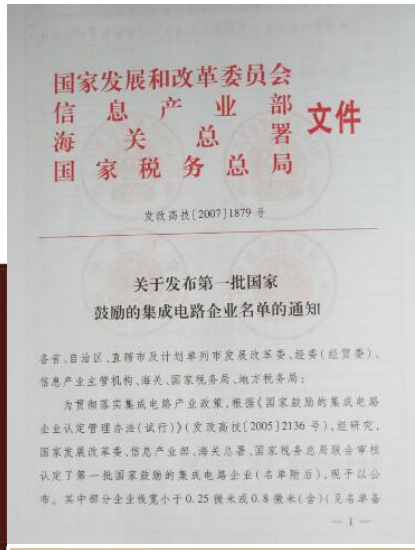
- 中国半导体材料十强企业

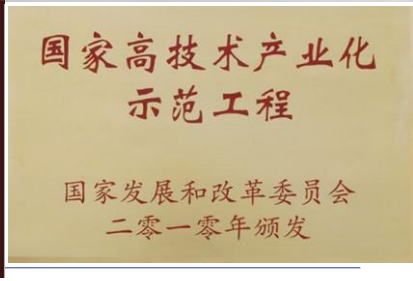
  (2015开始评选以来，连续五年排名硅片第一)

- 中国半导体支撑业最具影响力企业
- 国家创新型试点企业
- 国家鼓励的集成电路企业（首批）
- 国家高技术产业化示范工程

……

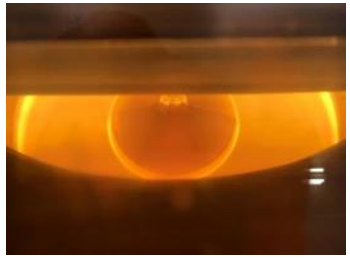


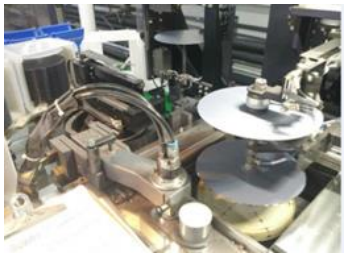


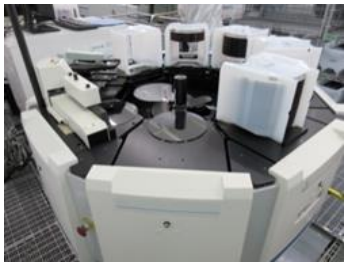


公司简介—核心竞争力

- 产业链上下游一体化优势
- 自主知识产权研发优势
- 行业先发优势和规模优势
- 质量与客户优势
- 技术平台和人才团队优势







2021年上半年经营业绩-经营情况讨论与分析

- 2020年三季度以来，受到“疫情经济”、半导体国产替代加快以及智能经济快速发展带动的下游需求持续增加等多种因素的影响，国内半导体行业进入了快速发展期，公司所处行业细分领域市场景气度不断提升，市场需求旺盛，公司销售订单饱满，产品供不应求。公司管理层在董事会的领导下，按照董事会制定的战略规划和经营计划，坚定不移践行“系统谋划，统筹配置、适时调整，满足需要”的总基调，充分发挥集团整体协同优势，积极应对市场变化，有效组织生产，加强内部控制管理，持续推进公司高质量发展。2021年上半年公司各项经营指标均取得了不错的成绩。

2021年上半年经营业绩-主要会计数据

单位：万元　币种：人民币

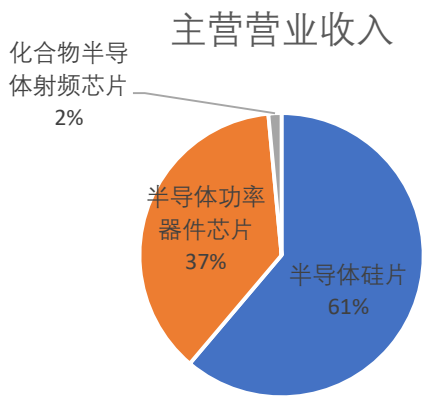
主要会计数据	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	102,838.34	64,852.06	58.57
营业成本	59,598.77	41,111.68	44.97
税金及附加	1,015.36	950.11	6.87
销售费用	870.39	496.48	75.31
管理费用	3,389.66	2,298.07	47.50
研发费用	8,712.13	4,549.26	91.51
财务费用	5,291.57	4,545.39	16.42
其他收益	3,440.69	2,154.72	59.68
信用减值损失	-39.32	-124.55	-68.43
资产减值损失	-2,855.34	-3,330.37	-14.26
归属于上市公司股东的净利润	20,897.49	7,621.12	174.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,385.98	5,504.84	234.00
经营活动产生的现金流量净额	8,124.82	6,151.93	32.07
	2021年6月末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%）
总资产	759,735.73	637,534.63	19.17
总负债	491,291.50	386,265.28	27.19
归属于上市公司股东的净资产	202,763.93	185,532.86	9.29

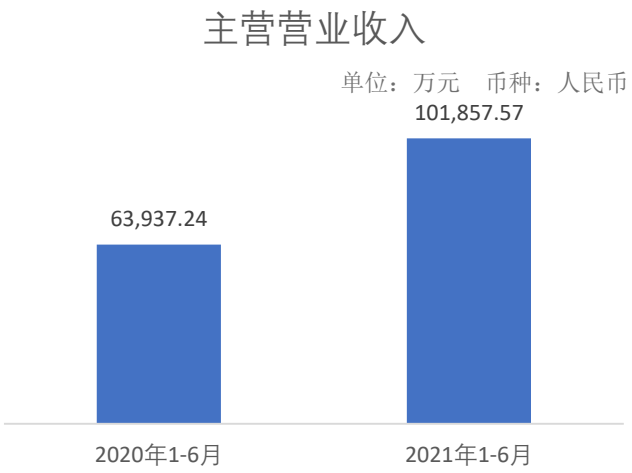
2021年上半年经营业绩-主要财务指标

主要财务指标	2021年1-6月	2020年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.52	0.21	147.62
稀释每股收益（元／股）	0.52	0.21	147.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.46	0.15	206.67
加权平均净资产收益率（%）	10.72	4.92	增加5.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.43	3.55	增加5.88个百分点
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.06	4.63	9.29%
资产负债率（%）	64.67	60.59	增加4.08个百分点

2021年上半年经营业绩-主营收入对比

主营业务分行业情况 单位：万元 币种：人民币			
分行业	2021年1-6月	2020年1-6月	增减率（%）
半导体	101,857.57	63,937.24	59.31
主营业务分产品情况			
分产品	2021年1-6月	2020年1-6月	增减率（%）
半导体硅片	62,313.68	43,320.08	43.84
半导体功率器件芯片	38,024.57	20,573.67	84.82
化合物半导体射频芯片	1,519.32	43.49	3393.49
主营业务分地区情况			
分地区	2021年1-6月	2020年1-6月	增减率（%）
境内	91,304.18	52,139.92	75.11
境外	10,553.39	11,797.32	-10.54





2021年上半年经营业绩-影响因素分析

- 行业景气度提升：受到“疫情经济”、半导体国产替代加快以及智能经济快速发展带动的下游需求持续增加等多种因素的影响，国内半导体行业进入了快速发展期，公司所处行业细分领域市场景气度不断提升，公司产业链一体化优势与规模效应优势得以进一步发挥，市场占有率稳步攀升。

- 市场需求旺盛及产品涨价因素：半导体功率器件产品的应用端光伏新能源行业、新能源汽车行业市场景气度有显著提升，对公司生产的高端器件产品的需求持续增加，虽然产能有较大提升，但仍难以满足市场的旺盛需求，供不应求态势明显。公司依据市场供需状况对半导体硅片、半导体功率器件芯片实施了涨价，直接增加了公司上半年的经营业绩。

2021年上半年经营业绩-影响因素分析（续）

- 产能储备超前：公司之前较早布局且完成了6英寸、8英寸硅片新产线建设，实施了功率器件芯片制造产线的产能技改提升，恰逢其时，较为充分地满足了不断趋热的市场需求，近期建成的12英寸硅片产线与微波射频芯片产线也迎来了较好的市场机遇，开始了规模化生产销售。

- 管理成效显著：现有的半导体硅片、半导体功率器件芯片产线通过工艺技术创新、管理提升和精益化生产，在技术改进、产品结构优化、良率提升和成本控制等方面成果显著，有效提升了产能与品质，与市场需求有较高的契合度。

2021年下半年经营工作计划

❖ 半导体硅片

继续推进衢州基地8英寸、12英寸硅片生产线的扩建工程，确保明年初按时实现投产；加大现有宁波基地和衢州基地6英寸硅片生产线的技术改造，进一步扩充产能。

❖ 半导体功率器件芯片

通过内部挖潜与技术改造，继续有效推进功率器件的产能提升，重点提高沟槽产品的生产能力与市场占有率，强化巩固公司在光伏芯片领域和汽车电子产品领域的领先地位，并快速提高通用电源高端客户产品总量的比例。

❖ 化合物半导体微波射频芯片

年内完成年产7万片的砷化镓微波射频芯片产能建设，并达到全年预定的出货销售目标；认真做好前期筹建工作，启动海宁化合物半导体微波射频芯片项目一期建设工程。

投资者交流